

★Beyond5G/6G対応部材の設計指針を、各部材の開発例や評価技術と併せて解説  
★市場動向や高周波に関する基礎知識も併せて学べる!

# Beyond 5 G / 6 G時代に求められる 部材技術と評価指針

発刊：2024年3月 定価：¥66,000(税込(消費税10%)) B5判ソフトカバー 309頁

- ◆市場概況、5 G / 6 Gに携わる上で必要な高周波の基礎解説
- ◆Beyond5G/6Gに向け、部材に求められる特性や高性能化への設計方針は?、  
⇒伝送損失、比誘電率、難燃性、加工性等...材料に必要な条件、選定基準は?  
⇒部材の構成とその理由、設計デザイン、製造方法、評価結果など
- ◆誘電特性の測定手法と使い分け方、誘電率 / 誘電正接の測定と算出方法
- ◆界面密着力や接着性向上方法、表面処理による難接着材の密着性向上技術、  
5 G / 6 Gにおけるパッケージング技術etc

詳細はWEBに掲載⇒<https://johokiko.co.jp/publishing/BC240301.php>  
又は「情報機構 BC240301」と検索

第1章 5G/6Gの動向と標準化シナリオ	第5節 材料評価
第2章 5G/6G理解に必要な高周波工学の基礎知識	第1項 材料評価と回路設計
第3章 各材料の低誘電材料技術と要求特性	第2項 材料評価技術～誘電率・誘電正接
第1節 部材側に必要な特性やパラメータ/付加機能性の全体的な方向性と設計指針	第3項 テラヘルツ分光によるガラス材料の誘電特性評価
第2節 5G/6G応用の電波吸収体設計事項と開発事例	第4章 接着・接合・加工技術
第3節 5G/B5Gギガヘルツ帯の電磁波吸収体の考え方と基本設計	第1節 5G/Beyond 5G 通信用高周波基板材料と導体の界面密着力
第4節 各部材の高周波対応技術	第2節 フッ素樹脂の接着性向上技術
第1項 低誘電・高接着ポリイミド「PIAD®」の物性と伝送損失評価	第3節 表面改質による難接着材料の密着性向上手法
第2項 プリント配線板、サブストレートを支える材料	第4節 プラズマ表面改質による接着剤・前処理フリー直接接着技術
第3項 5G/6G時代に向けた3Dプリンティング材料とその求められる特性	第5節 5G/6Gに向けたパッケージング技術
第4項 フッ素樹脂コンポジット材料の開発動向	
第5項 熱可塑性樹脂を用いた次世代通信用低誘電材料の開発	
第6項 広帯域CA電波吸収体の開発	
第7項 低誘電フィルム開発と高周波帯への応用	
第8項 活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の開発と実用化	
第9項 フッ素樹脂とシリカの低誘電特性を活かしたプリント基板用材料の開発	
第10項 発泡材料の開発と電波吸収材料への応用	
第11項 高周波用ふっ素樹脂多層基板の開発動向	

情報機構 BC240301 検索

※詳細はHPをご覧ください

FAX : 03-5740-8766、または、→<https://johokiko.co.jp>  
※FAX番号はくれぐれもお間違えの無い様お願い致します。

## ★書籍申込書

(書籍申し込み要領)

◎右記入の上、FAXでお申込を承ります。

◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および振込要領をお送りいたします。

◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認次第、受領書をお送りいたします。  
発刊時に弊社より書籍、請求書および振込要領をご送付いたします(送料は弊社負担)

◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込にてお願いいたします。原則として領収証の発行はいたしません。

◎振り込み手数料はご負担ください。

★ <https://johokiko.co.jp/>  
の申込みフォームからも承ります!

書籍名HP【BC240301】	
Beyond 5 G / 6 G時代に求められる部材技術と評価指針 書籍	
冊数	___冊 ※記入の無い場合は1冊
会社名	
所属部課・役職等	
申込者氏名	TEL
E-MAIL	上司役職・氏名
住所〒	
備考	
ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可) <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> 郵送	

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。  
今後のサービス向上のため「個人情報の取扱いに関する契約」を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp